

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，同意公司将募投项目“后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含90纳米及55纳米）”预定可使用状态的时间调整至2025年底，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年5月9日出具的《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）501,533,789股。公司每股发行价格19.86元，募集资金总额为9,960,461,049.54元，扣除发行费用236,944,589.63元后，募集资金净额为9,723,516,459.91元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月26日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2023年5月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合

集成首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	截至 2024 年 11 月 30 日累计投入金额 (实际支付口径)
1	合肥晶合集成电路先进工艺研发项目	490,000.00	355,003.35
1.1	后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）	60,000.00	40,029.17
1.2	微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）	35,000.00	-
1.3	40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目	150,000.00	107,603.19
1.4	28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目	245,000.00	207,370.98
2	收购制造基地厂房及厂务设施	310,000.00	276,393.67
3	补充流动资金及偿还贷款	150,000.00	151,727.42
合 计		950,000.00	783,124.44

注：截至 2024 年 6 月 30 日，募投项目“收购制造基地厂房及厂务设施”、“补充流动资金及偿还贷款”已结项，具体内容详见《晶合集成 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

公司结合“后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）”的实际进展情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	现计划项目达到预定可使用状态日期
后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）	2024 年底	2025 年底

注：公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审

议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目(包含 90 纳米及 55 纳米)”达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年底，具体原因详见公司于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-024）。

（二）本次募投项目延期原因

公司持续推进募投项目“后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）”的开发，已取得阶段性成果，具备生产后照式 CMOS 图像传感器芯片的技术能力。目前 90nm、55nm 中高阶 BSI 及堆栈式 CIS 芯片工艺平台实现大批量生产，终端应用包括手机、安防监控、相机等。

近年来，全球 CIS 销售额总体呈稳定增长态势，国产化进程加快给公司带来了新的发展机遇，CIS 已成为公司第二大主轴产品，因公司期望与客户合作更加多元化的产品应用及其衍生工艺平台（如旗舰版手机主摄芯片及多光谱感光元件等），故审慎决定将该募投项目“后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）”达到预定可使用状态的日期调整至 2025 年底，以保障募投项目顺利实施。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营

产生不利影响，符合公司发展规划。因此，监事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。

（二）保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2025年1月1日